

R16607 アプリケーション（システム）エンジニア

> **イー・エス・アイ・ジャパン株式会社での募集です。 アプリケーションエンジニアの...**

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
イー・エス・アイ・ジャパン株式会社

求人ID
1620074

業種
機械

会社の種類
外資系企業

雇用形態
正社員

勤務地
神奈川県

給与
750万円 ~ 900万円

勤務時間
09:00 ~ 17:30

休日・休暇
【有給休暇】入社日付与：入社月に応じて付与日数変化 / 次年度は10日付与 【休日】完全週休二日制（土・日）、祝日、年末年始休暇...

更新日
2026年10月29日 18:22

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2355599】
レーザードリル装置のアプリケーションエンジニア

ESIレーザードリル装置を用いたアプリケーション評価およびプロセス最適化を担当します。 レーザー加工プロセスの条件出し（DOE）、プロセスウィンドウの検証、顕微鏡・SEMによる品質評価、顧客デモおよび評価を通じて、顧客の製造課題解決を支援します。

主な職務内容
・レーザー加工プロセスの最適化
・ 次世代CO・・UVレーザー装置の導入支援
・ 顕微鏡・SEMを用いた加工品質評価
・顧客デモおよびアプリケーション評価支援
・ 国内外チーム（米国本社・営業・サービス）との技術連携
・ 生産設備技術や搬送システム導入等に関する技術サポート

スキル・資格

【必須】
・半導体、プリント基板、電子部品関連の「生産設備」に関する技術職経験者
・生産設備の制御プログラムや機械設計に関する経験、または関連する知識を有する方
・英語を用いたグローバル環境経験者
・大学卒以上工学部であれば尚可

【歓迎条件】
・レーザー加工プロセス経験者
・生産技術職経験者

・作業環境
安全規定に基づき必要な場合のPPE着用
機械部品、振動、騒音への偶発的な曝露
約10kgまでの物品を持ち上げる能力

会社説明

米国ESI（現在はMKS Inc.の傘下）の日本法人。ESIブランド製品の輸入・販売、据付、保守および技術サポートを提供。